

第 9 屆國際構裝暨電路板研討會 IMPACT-EMAP 2014

論文徵稿延期至 6/29 截止

敬請把握最後機會!! 錯過再等一年!

國際知名封裝、電路板、組裝技術殿堂 就差你一個

由於論文投稿反應熱烈，IMPACT-EMAP 2014 論文徵稿將延期至 6 月 29 日截稿，尚未投稿的產業先進，請把握最後投稿機會！全台最盛大的國際電子零組件、組裝、封測、電路板產業的年度盛會第 9 屆國際構裝暨電路板研討會(簡稱 IMPACT)，將在 10 月 22 至 24 日於南港展覽館舉辦，今年特別結合第 16 屆國際電子材料封裝研討會(簡稱 EMAP)共同合辦，同展期為全台最大電路板國際展覽 TPCA Show 2014。大會係由 IEEE CPMT-Taipei、IMAPS-Taiwan、工研院及台灣電路板協會共同主辦，獲國際學會 IEEE 和 iMAPS 認可，可謂是精華版的台灣 ECTC，研討會主題「挑戰變革、勾勒未來 Challenge for Change-Shaping the Future」，論文收錄進入最後黃金倒數階段，歡迎舊雨新知相偕參與這一年的盛會。

今年大會開幕演講陣容堅強，邀請到日月光執行長吳田玉博士、思科資深處長暨 IEEE-CPMT 全球總裁 JieXue、矽品研發副總經理馬光華博士、iNEMI 友會推薦之星科金朋亞洲區產品企劃副總 Chee-Kien Lim 等國際重量級講師參與，以及數十位來自全球的專家講師來台演講。贊助企業夥伴包括 OSAT 大廠矽品精密、封裝龍頭日月光、半導體大廠台積電、材料廠南亞塑膠、乾膜廠長興化工、化學廠阿托科技、電路板廠先豐通訊、軟板材料亞洲電材、跨國大廠陶式化學等。本會為台灣唯一橫跨上游材料、電路板半導體、封裝測試領域的國際級研討會，每年國外與會者達三成，是您不可錯過的年度盛會。

今年的企業主題論壇更加豐富多彩，矽品論壇去年獲得熱烈迴響，今年聚焦「Advance Package & 2.5D/3D IC」，世界封裝領導廠商-日月光推出「Heterogeneous 3D system integration」，上游電子材料大廠南亞塑膠也加入企業論壇的行列，讓 IMPACT-EMAP 2014 更加精彩可期。IMPACT 研討會不僅是學生教授發表論文的最佳平台，同時是產業界研發部門的年度成果發表會，竭誠歡迎國內外業界及學術界先進踴躍投稿，論文摘要截止日期延長至 6 月 29 日，歡迎各界踴躍投稿支持！投稿領域詳大會官網 www.impact.org.tw，或電 (03)3815659 分機 405 楊小姐。

【研討會】IMPACT-EMAP 2014 第 9 屆國際構裝電路板研討會暨第 16 屆國際電子材料封裝研討會

【展覽】TPCA Show2014 台灣電路板產業國際展覽會

【日期】2014 年 10 月 22-24 日(三-五)

【地點】台北南港展覽館

【線上投稿】<http://www.impact.org.tw>

【投稿重要時程】

2014 年 6 月 29 日--論文草稿截止(四百至五百字為限，請線上投稿)

2014 年 7 月 14 日--論文草稿核可(以電子郵件寄送通知)

2014 年 8 月 15 日--繳交完整論文(包含圖表共四頁，請線上繳交至大會網站)

2014 年 10 月 1 日--繳交口試論文發表資料(15 分鐘發表，內含 3 分鐘 Q&A)

【徵文內容概要】

IMPACT

Packaging

P1 -Advanced Packaging Technologies

P2. Green Packaging

P3-3D Integration

P4-LED & Optoelectronics Packaging

P5-Interconnections & Nanotechnology

P6-Modeling, Simulation & Design

P7-Thermal Management

P8- Advanced Sensor & Microsystems Technology (MST)

P9-Advanced Materials, Automatic Process & Assembly

P10-Emerging Systems Packaging Technologies

PCB

B1. Green Materials and Process

B2. Test, Quality, Inspection and Reliability Technology

B3. HDI and Embedded Technology

B4. Electro Deposition and Electrochemical Processing Technology

B5. Advanced and Emerging Technology

B6. Mechatronics and Automation

B7. Marketing & Management

EMAP

Materials and Packaging

M1. Materials and Processing

M3. Optoelectronics / Photonics

M5. Advanced Packaging

M7. Interconnection Technologies

M9. Electrical Modeling, Characterization, and Signal Integrity

M11. Quality and Reliability

M13. Flexible Electronics

M2. Passive and Active Components

M4. Sensor, Actuator, and Transducer Technologies

M6. Thru Silicon Via (TSV) Technology

M8. System-in-Package (SiP) and 3D Stacked Die Packaging

M10. Thermal-Mechanical Modeling and Characterization

M12. Packaging Technologies for High Brightness LEDs

M14. Others

* Papers relevant with the above scopes are encouraged to submit but NOT limited to.

* Conference authority keeps the right to final session arrangement.

【聯絡窗口】

台灣電路板協會 (TPCA)

電話: +886 3 381 5659 #405-楊庭芳小姐(Sylvia)

傳真: +886 3 381 5150

E-Mail: service@impact.org.tw

發稿單位	台灣電路板協會	發稿日期	2014.06.13
新聞聯絡人	邱筱雯 T:(03)3815659 #406 E: jessie@tpca.org.tw		
大會秘書處	楊庭芳 T:(03)3815659 #405 官網: www.impact.org.tw		